マニュアルボールワイヤーボンダ

省電力化につながるLED照明モジュールなどを試作できます。

ベアチップLEDなどの半導体チップを回路基板と結線する装置



7700型(ウエストボンド社)

<u>特徴</u>

- ワイヤーは25 μ m Φ の金線を使用
- 前後左右全方向に結線が可能
- ・接着面積の調整が可能



